

# 深圳市景旺电子股份有限公司

## 投资者调研交流会议记录

**会议时间：**2018年9月13日

**来访人员：**东方证券 蒯剑 杨旭 张惠娜 江舟、长信基金 陈言午 高远 祝昱丰、融通基金 朱丹、弘则弥道 欧阳志宏、大成基金 王晶晶、国金证券 樊志远 戴东哲、重阳投资 赵阳、汇鸿资产管理 范炳邑、华商基金 陈恒、招商基金 何文韬、领骥资本 王锐桥、西部证券 杜威、标朴投资 周明巍

**接待人员：**黄恬、覃琳香、程一鸣

**会议内容：**

### 一、2018年上半年度经营情况：

2018年上半年，公司董事会带领公司经营领导班子紧紧围绕公司长期发展战略和短期经营计划，制定了更为清晰的执行措施，坚持技术引领、创新驱动，使企业竞争优势得到进一步强化，增强了企业的盈利能力，为公司的长远发展奠定更为夯实的基础。公司持续深入渗透全球电子信息产业链，加大在汽车电子、高端消费电子、5G相关应用、工业控制等终端的客户开拓力度，成功引进了汽车电子、新能源、5G相关应用、OLED显示、无线充电等应用领域的客户，包括法雷奥、安波福、德尔福、三星SDC、宁德时代、安费诺、德普特等，为公司后续发展建立牢固的客户基础。公司科学严谨的推进江西二期项目智能化制造生产线的投产，并对公司各事业群各原有工厂持续进行技术改造，优化智能制造能力。

公司上半年营业收入为 22.75 亿，同比增长 15.47%，净利润为 3.91 亿，同比增长 23.82%。2018 年第二季度单季度营业收入为 12.89 亿，同比增长 21%，环比增长 31%，为公司单季营业收入及产值历史最高值。公司上半年毛利率为 32.63%，与去年同期相比有所提升。

## 二、交流环节：

**问：江西二期智能工厂将对公司产生哪些深远影响？**

答：PCB 产品制造工序多、生产流程长，长期以来不同生产流程工序相分离，呈点与点分布状态。江西二期智能工厂贯彻互联互通要求，有效实现上下游工作串联，从单点走向网络化，从单一系统走向集成化，有效解决“信息孤岛”问题，使各生产流程形成紧密相连、环环相扣的“链式结构”，并通过对管理系统的开发及应用，有效收集、分析、处理产线的生产数据并持续有优化下一次生产流程，构建智能工厂的“智慧大脑”，优化决策层和执行层间的互通互联机制。随着江西二期工厂的运营效率向峰值逐步攀进，将为公司硬板毛利率带来进一步的突破。

**问：公司软板生产效率提升较快的主要原因？**

答：公司 FPC 事业群持续进行技术改造，使瓶颈产能得到不断提升，并在上半年引进了 roll to roll 生产工艺，由此前片式生产模式过渡到当前的“连续性生产”模式，充分发挥了人力、物力的时间价值，有效提高生产效率。此外，公司上半年整合了电子装联生产工艺，通过集约化管理模式，集中生产力量，促使产能得到进一步释放。未来，

公司将逐步用硬板的毛利率指标要求软板，进一步提高软板的生产效率。

**问：公司销售费用增长的主要原因？**

答：公司长期以来通过“创新生产端”、“开拓市场端”同步驱动业绩发展，报告期内，公司持续强化国内市场占有率，加快开拓北美、欧洲、东南亚等国际市场，成功引进了汽车电子、新能源、5G 相关应用、OLED 显示、无线充电等应用领域的客户，包括法雷奥、安波福、德尔福、三星 SDC、宁德时代、安费诺、德普特等。报告期内，公司产品结构得到进一步优化，尤以汽车电子为代表的高端产品结构占比提升明显。

**问：如何看待 PCB 行业未来几年的发展？**

答：PCB 是电子信息产品的“土壤”，是电子信息产业得以发展的基础，随着万物互联时代的来临，势必带动 PCB 行业的蓬勃发展。PCB 具有产品种类多、定制化程度高、生产流程长、制造工序多等特点，因此行业的技术壁垒、管理能力壁垒与资金壁垒较高。随着 5G 时代的来临、电子产品更新换代速度加快、智能化普及领域拓宽，PCB 产品应用下游更广泛、需求量不断增加，具有技术、管理及资金优势的企业正处于快速发展的时期。

**问：请问如何看待公司未来的发展空间？**

答：1、目前全球 PCB 制造向中国大陆转移的趋势加深，中国大陆企业在全全球 PCB 的市场占有率正持续提升，公司 2017 年销售规模占全球市场份额大约 1%，存在很大的提升空间；2、电子信息行业的发展日新月异，对电子电路产品的生产能力提出更高的要求，只有通过持续的投入、持续的升级“换血”，才能保持竞争力，公司不断创新，包括新技术应用、智能工厂建设、数据化管理提升等，加大技术研究来匹配下游应用市场快速发展的节奏；3、公司确立了 PCB、FPC 双轮驱动的发展战略，同步发展 PCB、FPC、MPCB 三种产品，随着公司产业布局规划的逐步实施、中国 PCB 行业集中度不断提高，公司多元化的产品战略拥有更广阔的发展空间。

**问：请问公司扩产计划？**

答：1、江西二期智能工厂已经投放的产品线正处于产能爬坡阶段，同时公司正持续开展新产线的建设工作，推进二期工厂尽早达到产能目标；2、珠海基地“年产高密度印刷电路板 300 万 m<sup>2</sup>、柔性线路板 200 万 m<sup>2</sup>产业化项目”将分三期投资建设，首期投资 13.6 亿。目前公司已经取得项目的环评批复，珠海景旺产业化项目将在未来接力江西景旺，成为公司新的增长引擎。